公司代码：688627　　公司简称：精智达

深圳精智达技术股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能面临的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，请广大投资者予以关注。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.23元（含税）。截止2025年4月24日，公司总股本94,011,754.00股，扣除公司回购专用账户中股份总数为1,489,394.00股后的股本92,522,360.00股为基数，以此计算拟派发现金红利总额为人民币29,884,722.28元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为37.28%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	精智达	688627	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭娟	黄琳惠
联系地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D栋1楼东	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D栋1楼东
电话	0755-21058357	0755-21058357
传真	/	/
电子信箱	jzd@seichitech.com	jzd@seichitech.com

2、报告期公司主要业务简介

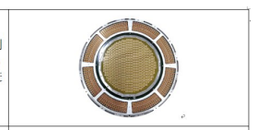
2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、半导体存储器件测试解决方案

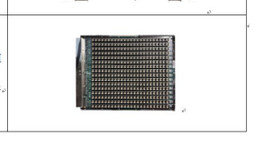
公司的半导体存储器件测试解决方案主要用于在DRAM等半导体存储器件的晶圆制造环节对晶圆上的裸片进行电参数性能和功能测试以及修复，或在封装测试环节对芯片颗粒进行电参数性能和功能测试、老化以及修复，以保证出厂的芯片性能和功能指标达到设计规范要求。

公司的半导体存储器件测试解决方案主要包括存储器晶圆测试系统、存储器老化测试及修复系统、存储器封装测试系统及其他测试配件等，具体情况如下：

（1）存储器晶圆测试系统

MEMS探针卡。	主要用于晶圆测试时实现测试机与被测芯片的电气联接，通过传输信号对芯片参数进行测试。	
DRAM CP测试机。	对DRAM晶圆制作完成后，封装前进行功能指标测试、电学参数测试及修复。	

（2）存储器老化测试及修复系统

主要产品名称。	产品简介。	产品图示。
DRAM老化测试及修复设备。	对封装后的芯片颗粒进行高低温与大电流环境下的老化测试，在测试中对颗粒内部缺陷进行修复。	
DRAM老化测试及修复治具板。	主要用于连接封装后DRAM芯片和老化测试ATE设备，是DRAM ATE中重要的部件。	

（3）存储器封装测试系统

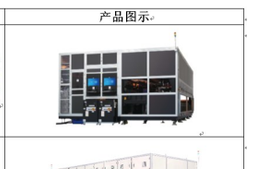
主要产品名称。	产品简介。	产品图示。
高速DRAM FT测试机。	对封装后的DRAM芯片颗粒进行高速接口测试。	
DRAM FT测试机。	对封装后DRAM芯片颗粒进行测试及修复。	
DRAM通用测试验证系统(UDS)。	面向DRAM设计及制造企业研发的紧凑型可移动测试系统。	

2、新型显示器件检测解决方案

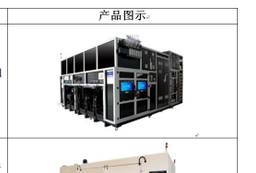
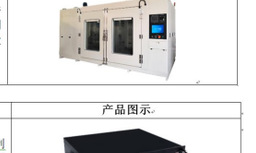
公司的新型显示器件检测解决方案主要用于AMOLED、TFT-LCD、微显示等新型显示器件的Cell与Module制程的光学特性、显示缺陷、电学特性等各种功能检测及校准修复，用于产品缺陷检测、产品等级判定与分类，对部分产品缺陷进行校准、修复及复判，从而提升产品良率、降低生产损耗，并为相关工序的工艺提升提供数据支撑。

公司的新型显示器件检测解决方案主要包括光学检测及校正修复系统、老化系统、信号发生器及检测系统配件等，具体情况如下：

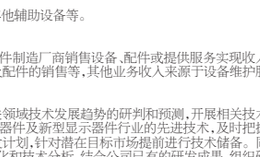
（1）光学检测及校正修复系统

主要产品名称。	产品简介。	产品图示。
Cell光学检测设备。	主要用于新型显示器件Cell制程的自动对位压接、白平衡调节、点灯/外观缺陷AOI检测、自动分类分级下料等工序。	
Module光学检测设备。	主要用于新型显示器件Module制程的Gamma调节、AOI检查、外观检查等工序。	
Micro LED/OLED模组AOI检测设备。	主要用于封装后Micro LED/OLED模组产品的Mura补偿，对产品进行点灯和外观缺陷AOI检测。	
Micro LED Wafer Test设备。	用于Micro LED/Micro OLED wafer产品点亮后的画面缺陷检查以及光学参数测量。	

（2）老化系统

主要产品名称。	产品简介。	产品图示。
Cell老化设备。	主要用于新型显示器件Cell制备后的点亮老化。	
Module老化设备。	主要用于新型显示器件Module开发设计过程中的例行试验，以及量产过程中的检验。	

（3）信号发生器及光学仪器

主要产品名称。	产品简介。	产品图示。
Cell信号发生器。	主要用于新型显示器件Cell制程的检测信号及电源供给，可用于点灯检测及老化等工序。	
Module信号发生器。	主要用于新型显示器件Module制程，可用于点灯检测、Gamma调节、Mura补偿及老化等工序。	
高分辨率成像式色亮度仪器。	本仪器主要用于更高分辨率的颜色检测，用来精确监测显示面板、微显示器件整体的亮度、色度及发光均匀性分布；同时可结合上位机，实现自动化色亮度、均一性测量，AOI相关检测（在超低亮情况下也可适用）。	

（4）检测系统配件

检测系统配件主要包括检测治具、检测耗材及其他辅助设备等。

2.2 主要经营模式

1. 盈利模式

公司通过向下游半导体存储器件和新型显示器件制造厂商销售设备、配件或提供服务实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于设备及配件的销售等，其他业务收入来源于设备维护服务等。

2. 研发模式

公司研发主要以市场需求为导向，并结合对相关领域技术发展趋势的研判和预测，开展相关技术的研发。公司研发团队密切关注及学习半导体存储器件及新型显示器件行业的先进技术，及时把握下游行业发展动向和产品革新信息，设定前瞻式研发计划，针对潜在目标市场提前进行技术储备。同时，公司研发团队基于不同的项目特点，进行需求细化和技术分析，结合公司已有的研发成果，组织研发力量进行开发并实现交付，在项目完成后将技术成果模块化、固定化，便于后续其他项目与产品研发重复使用与调取。通过市场与研发的衔接，公司研发输出符合市场需求的高质量产品，确保在技术上的可行性和经济收益上的稳定性，有效提高研发效率，降低研发风险。

3. 采购模式

公司主要根据产品销售订单设计参数并出具物料清单，制定原材料采购计划。对于部分交货期较长的核心原材料，公司根据市场情况进行适量备货，以及时响应客户需求。公司综合考虑产品质量、采购价格、订单交期、售后服务及合作关系的稳定性等因素选择供应商，已与主要供应商建立了长期且稳定的合作关系。

4. 生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，根据客户对所需产品的性能、规格、配置的要求进行定制化生产。公司产品生产严格遵循研发定型的硬件图纸与工艺说明，经过物料采购、硬件装配、软件安装、系统调试等一系列生产流程控制和严格的质量检验，最终交付客户合格的产品。

5. 销售模式

公司采用直销模式，产品主要向下游客户直接销售，通过商业谈判或招投标方式获取订单。公司与产业下游主流厂商建立了稳定的合作关系，深入了解客户需求，不断完善产品和服务，增加市场份额和品牌知名度。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）半导体测试行业

半导体存储器（动态存储器DRAM和NAND Flash）作为市场份额最大的单类产品，在整个半导体业务中占据了关键地位。随着以AI技术为核心的信息技术发展，DRAM技术也在不断升级，进一步扩大了未来的市场空间。根据TechInsights预测，2025年DRAM和NAND Flash存储行业市场销售额分别约为1,390亿美元及730亿美元，其中DRAM同比增长42%。全球DRAM市场份额高度集中，由三星、SK海力士及美光占据了90%以上的市场份额；随着国内政策利好，产业国产替代加快、应用领域拓展以及国际政经形势变化等因素，国内存储厂商技术追赶进展迅速，逐步向海外主流水平靠近，并提高市占率。

半导体测试贯穿整个半导体制造过程，广义上的半导体测试设备包括质量控制设备、测试设备和封装测试设备三类。晶圆测试设备和封装测试设备又称后道测试设备，包括分选机、测试机、探针台等，主要是用在晶圆加工之后的封装测试环节内，目的是检查芯片的性能是否符合要求，主要属于电性能测试。根据TechInsights数据，2024年全球存储器测试设备销售额达15亿美元、同比增长36.4%，2025年预计将进一步增至19亿美元，年复合增长率达26.7%。存储测试机当前主要被爱德万、泰瑞达等国外厂商占据主要市场份额，国产替代空间大、需求广阔。

半导体存储器测试技术门槛主要体现在以下方面：

第一，技术方面的难度比较大。由于半导体存储器测试的负荷大，在测试速度、时序精度、并行通道数量以及测试功能等方面的要求高于其它半导体测试设备；半导体存储器的测试过程中包含修复操作，需要专门的软件和算法配合；随着2.5D、3D等先进封装技术和Chiplet等集成技术的发展，测试设备要求日益复杂，例如AI算力芯片的测试需要测试设备能够同时完成SoC ATE和Memory ATE两个方面的功能，而且在测试向量深度、接口速度等方面都提出更高指标要求；除此之外，半导体存储器的测试实现需要依赖于整个系统，相应地对探针卡、治具、连接器等方面的指标要求也会提高。

第二，客户对测试设备兼容度要求比较高。因为半导体存储器的测试功能要求复杂，需要针对所使用的机台建立专门的测试程序开发团队，并针对所有产品开发特定的测试程序，会形成比较大的成本投入，造成较高的既有测试平台依赖性。因此，导入新测试平台必须考虑如何实现与客户既有机台的兼容，以降低客户测试机台更换型号的难度。

第三，测试设备认证要求高。客户对于新设备认证程序严格，流程复杂，并且在认证过程中需要投入大量测试样品，导致客户认证成本高昂。因此测试设备厂商获得客户认证资格的准入门槛高。

（2）新型显示行业

显示器件在信息交流中承担了人机交互作用，是信息传输过程中的关键环节。目前主要应用的新型显示器件中，AMOLED产品的工艺持续改进，应用形态快速拓展，技术创新与规模效应带动成本不断下降，目前在以手机为代表的消费电子领域渗透率逐步提升；与此同时，Mini LED、Micro LED、Micro OLED及激光投影显示等技术崭露头角，国内外微型显示器件制造厂商争相投资加码。公司在技术上不断沉淀和突破，积极与终端头部厂商寻求合作，力求占领市场先机。

新型显示器件制造设备行业的发展受下游产业的新增产线投资及针对新技术、新产品的产线升级投资所驱动，与显示产业的发展具有极高的联动性。其中，检测工艺贯穿于新型显示器件生产过程的Array（阵列）-Cell（成盒）-Module（模组）三大制程中。

AMOLED小尺寸产品的技术、制程已经基本成熟，在手机市场渗透率持续提升；AMOLED中尺寸产品正逐步向IT、车载、平板显示等应用市场渗透，G8.6产线建设带来行业新一轮投资热潮；

Micro LED和Micro OLED工艺AR/VR市场已经获得推广应用，技术和制程工艺仍处于发展提升阶段，多数国内头部企业也已经提出了量产投资计划，部分投资项目已经启动，带来了生产和检测设备的需求；从技术发展格局来看，相关检测设备技术需求仍然存在演变空间，设备供应商需要密切跟进产品技术的发展，才能及时满足客户的需求。

新型显示器件检测设备的生产制造是复杂的系统工程，需要综合利用新一代信息技术领域的光学、电学、自动化等多项技术，具备生产加工装配能力从而将多项独立组件结合以实现相应功能，具备软件开发能力以实现算法应用并具备软硬件有机结合能力，并经过长期技术积累及改良，以实现检测设备在极高精密要求的新型显示器件生产过程中实现极微小的缺陷、不良等检出，助力下游客户有效提升产品良率和生产效率。不同显示器件厂商对显示器件产品的检测要求、性能参数存在差异，检测设备需要与产线不断磨合改进，积累设备在生产线应用经验并推进新产品、新技术的研发，持续提升产品技术水平及产线适应水平。检测设备厂商与显示器件厂商之间的关系依赖于长时间合作产生的信任以及技术互惠，共同完成技术更新及迭代，形成更具实践性的研发成果，检测设备定制化和针对性极强，具备较高的客户资源以及技术壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在半导体测试设备领域，公司主要聚焦于半导体存储器测试，注重全方位的测试业务覆盖，产品线包含从晶圆测试设备、老化测试及修复设备、FT测试设备、高速FT测试设备等核心产品，到MEMS探针卡（Probe Card）、老化治具板（BIB）、FT测试治具（DSA）等与半导体存储器测试相关的所有关键设备和治具，是目前国内少数的半导体存储器测试设备业务全覆盖的厂商之一，初步具备系统化全站点服务能力。在探针卡产品线和老化测试及修复设备产品线方面，公司已经成功取代国外供应商并成为相关设备主力供应商，实现重要生产环节自主可控；在FT测试设备产品线方面，公司已与主要客户签订采购协议，目前正在持续交付相关设备，此外公司已向主要客户交付高速FT测试机进行验证，测试机专用ASIC芯片（最高可实现9Gbps信号输出与校准）已获得客户认可，标志着公司在高速芯片测试领域取得重要突破。

在新型显示器件检测设备领域，公司致力于实现产品国产化替代及创新，在柔性AMOLED领域核心产品已在包括京东方、TCL科技、维信诺股份、深天马等主流新型显示器件厂商制造产线批量应用，涵盖从Cell段到Module段所有的检测设备，市占率持续提升；在中尺寸显示器件领域，公司积极加快技术的更新迭代与创新研发，在AMOLED车载、笔电、折叠屏等领域快速适配客户新需求，积极研发可适用于G8.6 AMOLED产线的Cell及Module相关检测设备，积极参与主要客户新产线相关需求产品的技术验证测试和设备评估，并取得批量订单；在微型显示领域，公司与国内外行业龙头企业保持良好的业务关系，开发出用于Micro LED/Micro OLED的信号发生器、晶圆检测设备、光学检测及校正修复设备、最终成品检测设备等产品，并实现量产销售。公司已率先实现向海外重要AR/VR终端客户提供系统化检测解决方案，已获取订单并实现收入。

综上，公司已与国内主流半导体存储器件及新型显示器件制造厂商建立了紧密稳定的业务合作关系、相关产品的技术水平与上述客户的产品技术发展规划同步布局，竞争实力逐步攀升，市场占有率不断扩大，持续有力地推进关键检测及测试工艺相关设备的自主可控和国产替代进程。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）半导体存储器件及其测试设备行业

① 先进封装技术对半导体行业的促进日趋明显

随着摩尔定律逐渐逼近极限，传统的通过芯片制造工艺升级获得芯片性能提升的路线面临着巨大的挑战，而通过先进封装技术提升半导体器件的性能成为重要手段。先进封装则是指采用新的封装工艺和材料，将多个芯片、元器件集成在一个封装之内，以提高芯片的性能、功耗和可靠性。先进封装技术包括2.5D封装、3D封装、扇出型封装以及Chiplet等多种类型，应用于各个领域的芯片产品。其中，Chiplet技术使得SoC设计商可以选择不同厂商芯片构成完成系统，大大扩展设计灵活度，同时进一步扩展先进封装的应用机会。

②人工智能发展驱动基础设施升级

从当前技术发展的角度来看，人工智能（AI）是推动科技进步和产业变革的关键力量。以DeepSeek为代表的国内AI企业的快速发展以及相关AI生态系统的日趋完善，对算力基础设施会提出新的要求，从而对高性能处理器、存储器、通信芯片、计算服务器以及大容量存储等半导体产品产生巨大的市场需求。而算力作为AI的关键竞争点，对存储器的容量和速度也都提出了更高的需求。尤其是在AI服务器和车载自动驾驶领域，目前已经成为了半导体存储器新增市场的重点。AI发展与数据中心建设成为半导体行业增长重要驱动因素，大模型训练及边缘计算推动高算力芯片需求，带动先进封装技术的提升和普及，以及相关测试设备需求增长。

③HBM成为半导体存储技术热点技术

随着人工智能、大数据和云计算的快速发展，芯片对存储性能与数据传输速度的需求显著提升，传统内存技术已难以满足。HBM通过将多个DRAM芯片堆叠在一起，可以大幅提升存储器的带宽和容量。HBM主要应用于高端服务器、人工智能、GPU等领域，是未来计算系统发展的重要基础。HBM及先进封装技术的发展将推动半导体行业进入新的发展阶段，为人工智能、大数据、物联网等新兴产业的发展提供强有力的技术支撑，同时也产生对相关测试设备的巨大的需求。

④国内主要半导体存储器件厂商加快国产替代进程

近年来，为了提升产业链自主可控能力，国内主要半导体存储器件厂商加快了国产替代进程，协同供应链进一步提升产品技术水平。尽管目前在半导体存储器件的测试设备领域依然是国外知名厂商暂时处于优势地位，但在产业链协同发展的基础上国产设备厂商在技术和产品方面也取得重大进展。

⑤系统化全站点服务能力成为测试设备厂商核心竞争力

系统化全站点服务能力意味着测试设备厂商能够提供涵盖各测试节点的设备品类及其硬件、软件、算法、数据分析等在内的全面解决方案。具备系统化全站点服务能力的测试设备厂商能够服务客户的不同需求，提供由多品类、高精度、互相兼容的设备构成的完整测试系统解决方案，灵活配置和定制测试系统，提高设备的兼容性和适应性。由于DRAM厂商持续迭代升级芯片，由多品类设备构成的全站点测试系统可以通过设备升级、硬件更换、软件迭代等多种方式，快速实现对不同产品的测试切换，提升研发创新品质，降低客户使用成本。

（2）新型显示器件及其检测设备行业

①AR/VR产品及AI眼镜带动微显示技术产业化进程全面提速

2024年初，苹果Vison Pro正式发售，其搭载的双Micro OLED屏幕实现单眼4K显示效果，带动消费级产品显示标准跃升；2024年9月，Meta推出首款AR眼镜原型Orion2，采用JBD提供的全彩Micro LED微显示屏，并已推出或即将推出多款AI智能眼镜。根据Counterpoint Research，Meta旗下智能眼镜Ray-Ban Meta智能眼镜通过将可穿戴AI技术与时尚设计和增强的智能功能相结合，推动2024年全球智能眼镜的出货量实现了同比210%的显著增长，首次突破200万台大关。在国内市场，雷鸟创新、Rokid、影目科技、闪极科技等众多厂商已纷纷推出AI眼镜，字节跳动、小米、华为、中国移动、中国电信等巨头也在积极布局，预计2025年内均有望发布相关新品，AI眼镜产品矩阵加速扩充，国内AR眼镜行业也出现量纪魅族、雷鸟创新、Rokid、XREAL、INMO等代表性企业及品牌。根据IDC预测，2030年全球AI眼镜市场规模将达到3,000亿美元。

AR+AI智能眼镜探索人工智能与增强现实的信息叠加，技术门槛高但未来前景广阔。以DeepSeek为代表的通用人工智能底层模型与技术持续升级迭代带来AI大模型API成本优化，降低XR内容生成门槛，加速开发者生态繁荣，全球AR/VR产业进入硬件迭代与生态扩张并行期。

在此环境下，国内微型显示屏制造厂商持续新增投资，在技术上不断沉淀和突破，其中JBD已于2024年底宣布垂直堆叠技术的Phoenix系列单片全彩微显示屏实现250万尼特亮度的新纪录并计划在2025年三季度量产，原生单片RGB Micro LED技术商业化成果显著，为国产显示检测设备厂商带来新的机会。

②中尺寸AMOLED投资增加，产线开始建设

得益于AMOLED技术的不断成熟和良率提升，AMOLED的屏体尺寸也开始向中尺寸方向迈进，平板电脑、笔记本电脑、工控显示、车载显示等中尺寸应用场景对AMOLED的需求逐步成为现实，尤其是在车载显示方面，AMOLED技术与LCD技术相比，在显示效果、柔性和曲面屏体等方面具备明显优势，客户替代需求更为迫切。应用和需求的增长拉动AMOLED产线投资，京东方、维信诺等主要新型显示器件厂商均在报告期内提出了新的G8.6产线建设计划，同时也在不断通过技术升级改造方式，扩展既有产线的产能。

③前段制程设备国产化进程有待推进

报告期内，新型显示行业在生产和测试设备国产化方面继续取得进展。模组段的制程设备和检测设备国产化率已经非常高，但是前段制程中的相关设备依然严重依赖进口。基于当前国际形势对技术封锁和供应链断供风险的加剧，国内各显示器件厂商对供应链安全可控的迫切需求，也为前段设备国产化带来战略机遇，国产设备厂商需要在前段制程设备方面给予更多关注和投入。

④AMOLED折叠屏在国内市场快速发展

根据CINNO Research数据，2024年中国市场折叠屏手机同比增长约83%，预计2027年中国市场折叠屏手机销量有望达6,497万部、市场渗透率达11.2%。由于AMOLED折叠屏未来的旺盛需求以及当前的产品生产效率限制，主要新型显示器件厂商有望进一步增加折叠屏产线产能。

⑤新型显示器件制造智能化升级需求拉动新型检测需求

在新型显示部分制程中，画质检查复判和外观检测仍依赖全人工目检。在人工智能时代下，该等检测方式已成为制约企业降本增效的关键瓶颈，进一步智能化升级成为行业共性需求，拉动显示器件外观检测设备、AI自动检测分类系统等新型检测增量市场。

总体而言，新型显示行业的发展对于国内测试设备行业的厂商，提供了更加广阔的发展空间。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,030,354,809.18	1,996,487,508.09	1.70	962,685,876.33
归属于上市公司股东的净资产	1,721,973,056.36	1,719,227,487.47	0.16	602,710,504.39
营业收入	803,129,707.64	648,563,325.45	23.83	504,584,397.07
归属于上市公司股东的净利润	80,160,244.51	115,684,848.18	-30.71	66,068,016.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,855,656.78	84,346,700.88	-18.37	52,637,091.27
经营活动产生的现金流量净额	14,564,741.84	-13,548,051.46	不适用	-33,965,443.38
加权平均净资产收益率(%)	4.66	10.71	减少6.05个百分点	11.67
基本每股收益(元/股)	0.8562	1.4406	-40.57	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.8562	1.4406	-40.57	0.94
研发投入占营业收入的比例(%)	13.66	11.08	增加2.58个百分点	9.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	83,046,976.27	278,557,517.00	204,594,175.38	236,931,038.99
归属于上市公司股东的净利润	-14,442,579.38	52,648,436.49	13,174,582.45	28,779,804.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,201,223.48	49,238,834.80	10,368,475.28	27,449,570.18
经营活动产生的现金流量净额	-105,365,446.13	15,277,913.58	-25,166,177.28	129,818,451.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,942
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,905
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张滨	0	17,474,715	18.59	17,474,715	无	0	境内自然人
深圳国中创业投资管理有限公司—深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	5,230,902	5.56	0	无	0	其他
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)	0	5,046,720	5.37	0	无	0	其他
北京石溪清流私募基金管理有限公司—合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-940,117	3,232,343	3.44	0	无	0	其他
三亚市采希壹号私募基金合伙企业(有限合伙)	-44,583	2,639,628	2.81	0	无	0	其他
深圳市外滩科技开发有限公司	-916,858	2,454,291	2.61	0	无	0	境内非国有法人
深圳市苹通投资合伙企业(有限合伙)	0	2,410,040	2.56	2,410,040	无	0	其他
广东红土创业投资管理有限公司—深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)	0	2,247,432	2.39	0	无	0	其他
深圳源创力清源创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,089,869	2.22	0	无	0	其他
常州清源天使创业投资合伙企业(有限合伙)	0	1,789,476	1.90	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市萃通为公司员工持股平台，张滨担任深圳市萃通执行事务合伙人，系一致行动人。源创力清源、常州清源、新麟二期的执行事务合伙人及管理人同受深圳清源时代投资管理控股有限公司控制，互为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

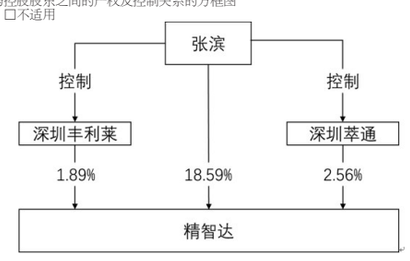
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

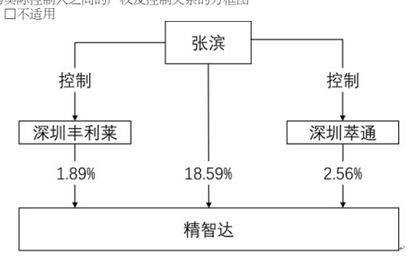
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入80,312.97万元，同比增长23.83%；归属于上市公司股东的净利润8,016.02万元，同比下降30.71%。截至报告期末，公司资产总额203,035.48万元，归属于上市公司股东的净资产172,197.31万元，财务状况稳健。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688627　　证券简称：精智达　　公告编号：2025-030

深圳精智达技术股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利人民币3.23元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币80,160,244.51元，报告期末，母公司报表中可供分配利润为人民币224,590,884.22元。经董事会决议，公司2024年年度利润分配预案如下：

2024年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.23元（含税）。截止2025年4月24日，公司总股本94,011,754.00股，扣除公司回购专用账户中股份总数为1,489,394.00股后的股本92,522,360.00股为基数，以此计算拟派发现金红利总额为人民币29,884,722.28元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为37.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司于2023年7月18日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度。公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本年度利润分配预案符合《深圳精智达技术股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配预案并同意提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状与《深圳精智达技术股份有限公司章程》中关于现金分红政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688627　　证券简称：精智达　　公告编号：2025-032

深圳精智达技术股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。

2024年度公司计提各项减值准备合计2,538.21万元，具体情况如下表所示：

单位：人民币 万元

项目	2024年度计提金额	备注
信用减值损失	1,720.88	含应收账款、其他应收款坏账损失
资产减值损失	817.33	含存货、合同资产减值损失
合计	2,538.21	

二、计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失1,720.88万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司按照各类存货成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备，并结合各类存货的实际情况（如原材料库龄结构等）并基于谨慎性原则，最终确定跌价金额；对合同资产采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提资产减值损失817.33万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提各项资产及信用减值损失共计2,538.21万元，合计对公司2024年度合并报表利润总额影响2,538.21万元（合并利润总额未计算所得税影响）。该数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大影响。

四、其他说明

2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025